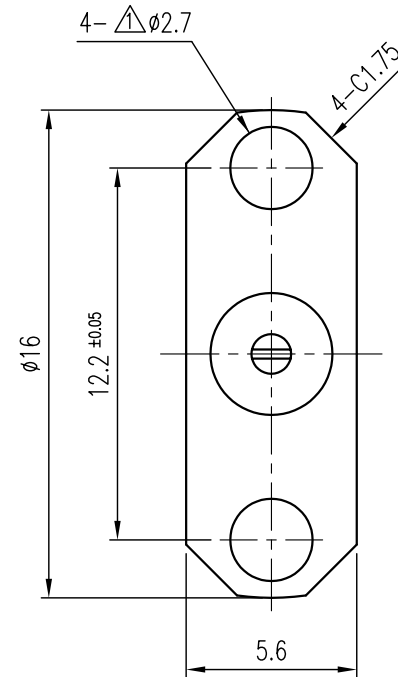
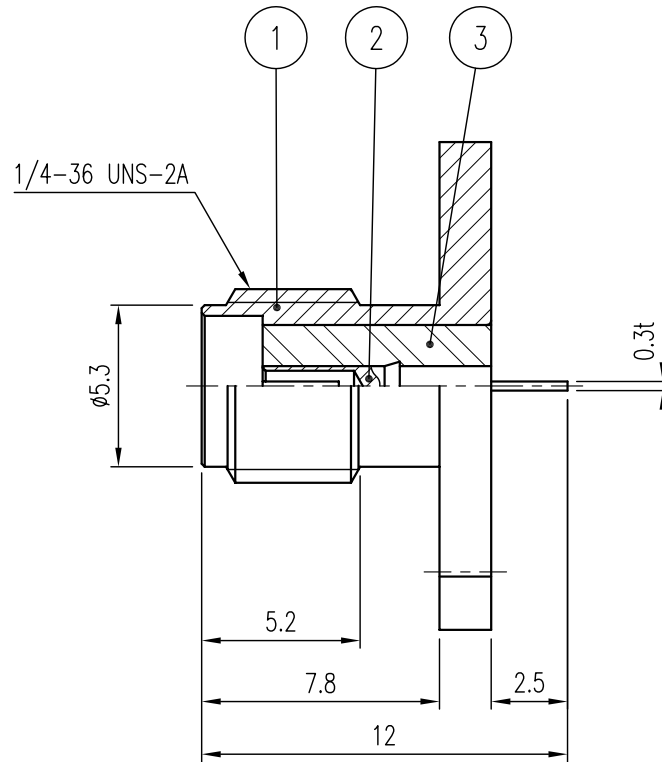


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00090-N/1
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00262-5/1
1	BODY	1	MBSBD	Gold Plate	DBD00347-5/1
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질		품번		품명		수량	재질	표면처리	비고
공통공차		년월일 2003. 11. 6.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. SMA50 SOLDER END JS-2H			
소수 각도 분수 _____		승인							
재질 _____		검도				도명			
		제도							
열처리 _____		작성부서				A4			
		연 구 소							
보호파막처리 _____		적도 4/1		단위 mm	중량 _____	도번 CN00141-7/1 K314-481-005			